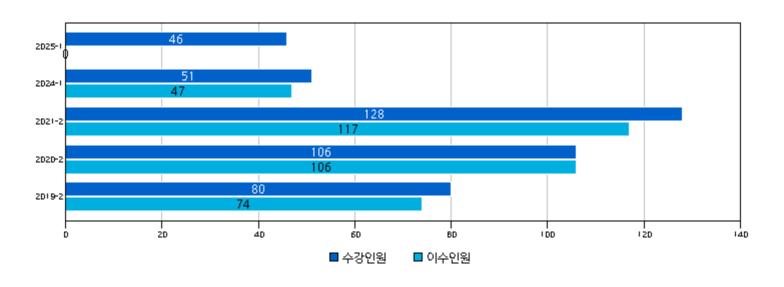
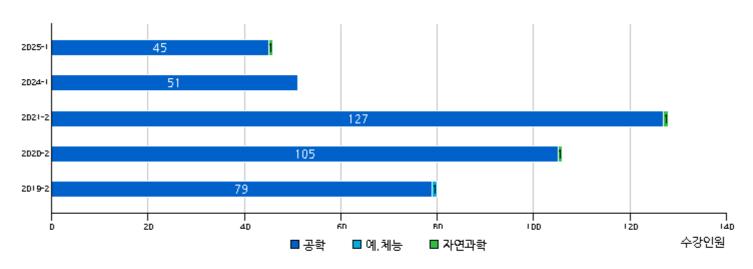
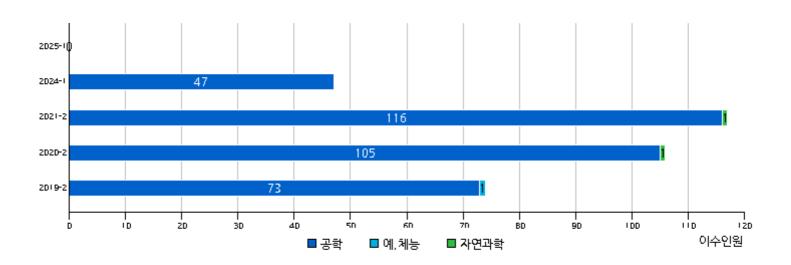
1. 교과목 수강인원



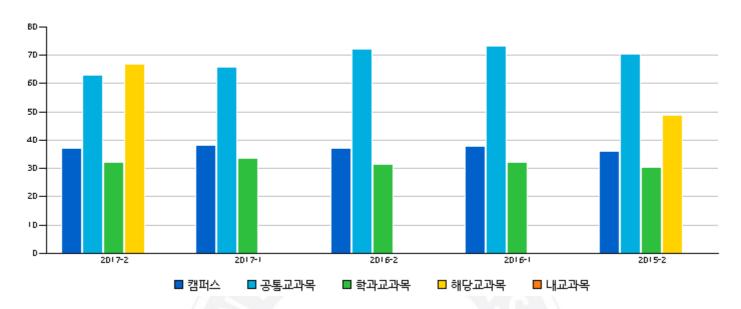




수업년도	수업학기	계열구분	수강인원	이수인원
2019	2	공학	79	73
2019	2	예,체능	1	1
2020	2	자연과학	1	1
2020	2	공학	105	105
2021	2	자연과학	1	1
2021	2	공학	127	116
2024	1	공학	51	47
2025	1	자연과학	1	0
2025	1	공학	45	0

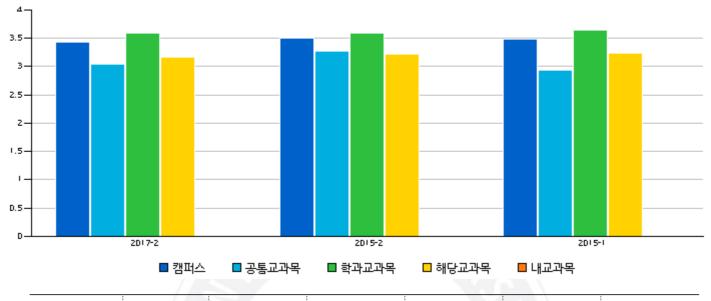


2. 평균 수강인원



수업년도	수업학기	캠퍼스	공통교과목	학과교과목	해당교과목	내교과목
2017	2	37.26	63.09	32.32	67	
2017	1	38.26	65.82	33.5		
2016	2	37.24	72.07	31.53		
2016	1	37.88	73.25	32.17		
2015	2	36.28	70.35	30.36	49	

3. 성적부여현황(평점)



수업년도	수업학기	캠퍼스	공통교과목	학과교과목	해당교과목	내교과목
2017	2	3.44	3.05	3.59	3.16	
2015	2	3.51	3.28	3.6	3.23	
2015	1	3.49	2.94	3.64	3.24	

4. 성적부여현황(등급)

2021

2021

2021

2021

2021

A+

Α0

ВО

C+

2

2

2

2

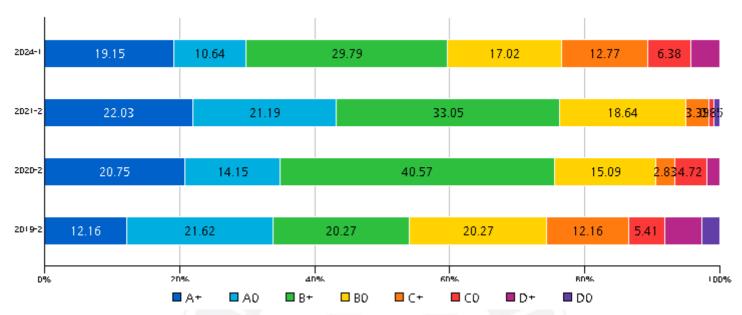
26

25

39

22

4



수업년도	수업학기	등급	인원	비율	수업년도	수업학기	등급	인원	비율
2019	2	Α+	9	12.16	2021	2	C0	1	0.85
2019	2	Α0	16	21.62	2021	2	D0	1	0.85
2019	2	B+	15	20.27	2024	1	Α+	9	19.15
2019	2	ВО	15	20.27	2024	1	A0	5	10.64
2019	2	C+	9	12.16	2024	1	B+	14	29.79
2019	2	C0	4	5.41	2024	1	ВО	8	17.02
2019	2	D+	4	5.41	2024	1	C+	6	12.77
2019	2	D0	2	2.7	2024	1	C0	3	6.38
2020	2	Α+	22	20.75	2024	1	D+	2	4.26
2020	2	Α0	15	14.15					
2020	2	B+	43	40.57					
2020	2	ВО	16	15.09					
2020	2	C+	3	2.83					
2020	2	C0	5	4.72					
2020	2	D+	2	1.89					

22.03

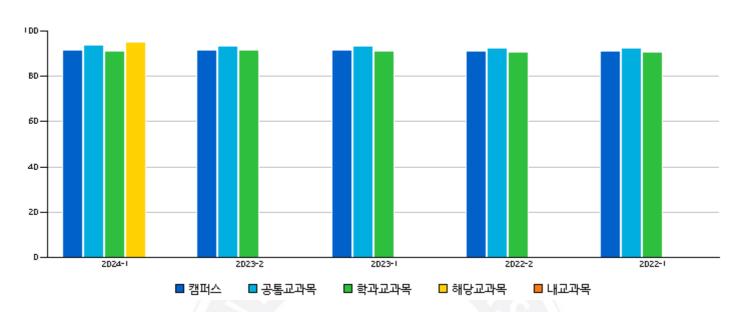
21.19

33.05

18.64

3.39

5. 강의평가점수



 수업년도	수업학기	캠퍼스	공통교과목	학과교과목	해당교과목	내교과목
2024	1	91.5	93.79	91.1	95	
2023	2	91.8	93.15	91.56		
2023	1	91.47	93.45	91.13		
2022	2	90.98	92.48	90.7		
2022	1	90.98	92.29	90.75		

6. 강의평가 문항별 현황

		L OLT	.179			점수별 인원분포					
번호	평가문항	본인평 균 (가중 치적용)		차	학평균 이 ,-:미딜		매우 그렇 치않 다	그렇 치않 다	보통 이다	그렇 다	매우 그렇 다
		5점	학	과	대	학	1점	2점	3점	4점	5점
	교강사:	미만	차이	평균	차이	평균	178	2 2	2.5	473	2.5

No data have been found.

7. 개설학과 현황

학과	2025/1	2024/1	2021/2	2020/2	2019/2
신소재공학부	2강좌(6학점)	1강좌(3학점)	2강좌(6학점)	2강좌(6학점)	2강좌(6학점)

8. 강좌유형별 현황

강좌유형	2019/2	2020/2	2021/2	2024/1	2025/1
일반	2강좌(80)	2강좌(106)	2강좌(129)	1강좌(51)	2강좌(46)

9. 교과목개요

교육과정	관장학과	국문개요	영문개요	수업목표
학부 2024 - 2027 교육과 정	서울 공과대학 신소재공학부	IC 공학의 적용과 발전에 있어서 놀라운 발전이 독립적인 분야로서의 전자공학을 등장시켰다. 또한 IC의 광범위한 사용은 전자공학과 이와 관 련된 산업이 IC의 동작과 한계의 기본적인 이해 를 할 수 있는 다양한 영역의 공학도를 필요로 한다. 이 강좌는 대부분의 IC 테크놀로지에 공통적으 로 사용되는 기본적인 공정을 소개하고, 좀 더 진보된 공정과 디자인 방향을 이해할 수 있는 기 본지식을 제공한다. 그리고 물질의 범위를 제한 하기 위해서 이 강좌에서는 실리콘 프로세싱과 패키징에 관련된 물질만을 다루기로 한다.	The spectacular advances in the development and application of integrated circuit (IC) technology have led to the emergence of microelectronics process engineering as an independent discipline. Additionally, the pervasive use of integrated circuits requires a broad range of engineers in the electronics and allied industries to have a basic understanding of the behavior and limitations of ICs. This course presents an introduction to the basic processes common to most IC technologies and provides a base for understanding more advanced processing and design courses. In order to contain the scope of the material, we deal only with material related to silicon processing and packaging.	

 교육과정	관장학과	국문개요	영문개요	수업목표
학부 2020 - 2023 교육과 정	서울 공과대학 신소재공학부	IC 공학의 적용과 발전에 있어서 놀라운 발전이 독립적인 분야로서의 전자공학을 등장시켰다. 또한 IC의 광범위한 사용은 전자공학과 이와 관 련된 산업이 IC의 동작과 한계의 기본적인 이해 를 할 수 있는 다양한 영역의 공학도를 필요로 한다. 이 강좌는 대부분의 IC 테크놀로지에 공통적으 로 사용되는 기본적인 공정을 소개하고, 좀 더 진보된 공정과 디자인 방향을 이해할 수 있는 기 본지식을 제공한다. 그리고 물질의 범위를 제한 하기 위해서 이 강좌에서는 실리콘 프로세싱과 패키징에 관련된 물질만을 다루기로 한다.	The spectacular advances in the development and application of integrated circuit (IC) technology have led to the emergence of microelectronics process engineering as an independent discipline. Additionally, the pervasive use of integrated circuits requires a broad range of engineers in the electronics and allied industries to have a basic understanding of the behavior and limitations of ICs. This course presents an introduction to the basic processes common to most IC technologies and provides a base for understanding more advanced processing and design courses. In order to contain the scope of the material, we deal only with material related to silicon processing and packaging.	
학부 2016 - 2019 교육과 정	서울 공과대학 신소재공학부	IC 공학의 적용과 발전에 있어서 놀라운 발전이 독립적인 분야로서의 전자공학을 등장시켰다. 또한 IC의 광범위한 사용은 전자공학과 이와 관 련된 산업이 IC의 동작과 한계의 기본적인 이해 를 할 수 있는 다양한 영역의 공학도를 필요로 한다. 이 강좌는 대부분의 IC 테크놀로지에 공통적으 로 사용되는 기본적인 공정을 소개하고, 좀 더 진보된 공정과 디자인 방향을 이해할 수 있는 기 본지식을 제공한다. 그리고 물질의 범위를 제한 하기 위해서 이 강좌에서는 실리콘 프로세싱과 패키징에 관련된 물질만을 다루기로 한다.	The spectacular advances in the development and application of integrated circuit (IC) technology have led to the emergence of microelectronics process engineering as an independent discipline. Additionally, the pervasive use of integrated circuits requires a broad range of engineers in the electronics and allied industries to have a basic understanding of the behavior and limitations of ICs. This course presents an introduction to the basic processes common to most IC technologies and provides a base for understanding more advanced processing and design courses. In order to contain the scope of the material, we deal only with material related to silicon processing and packaging.	
학부 2013 - 2015 교육과 정	서울 공과대학 신소재공학부	IC 공학의 적용과 발전에 있어서 놀라운 발전이 독립적인 분야로서의 전자공학을 등장시켰다. 또한 IC의 광범위한 사용은 전자공학과 이와 관 련된 산업이 IC의 동작과 한계의 기본적인 이해 를 할 수 있는 다양한 영역의 공학도를 필요로 한다. 이 강좌는 대부분의 IC 테크놀로지에 공통적으 로 사용되는 기본적인 공정을 소개하고, 좀 더 진보된 공정과 디자인 방향을 이해할 수 있는 기 본지식을 제공한다. 그리고 물질의 범위를 제한 하기 위해서 이 강좌에서는 실리콘 프로세싱과 패키징에 관련된 물질만을 다루기로 한다.	The spectacular advances in the development and application of integrated circuit (IC) technology have led to the emergence of microelectronics process engineering as an independent discipline. Additionally, the pervasive use of integrated circuits requires a broad range of engineers in the electronics and allied industries to have a basic understanding of the behavior and limitations of ICs. This course presents an introduction to the basic processes common to most IC technologies and provides a base for understanding more advanced processing and design courses. In order to contain the scope of the material, we deal only with material related to silicon processing and packaging.	

교육과정	관장학과	국문개요	영문개요	수업목표
학부 2009 - 2012 교육과 정	서울 공과대학 신소재공학부	IC 공학의 적용과 발전에 있어서 놀라운 발전이 독립적인 분야로서의 전자공학을 등장시켰다. 또한 IC의 광범위한 사용은 전자공학과 이와 관 련된 산업이 IC의 동작과 한계의 기본적인 이해 를 할 수 있는 다양한 영역의 공학도를 필요로 한다. 이 강좌는 대부분의 IC 테크놀로지에 공통적으 로 사용되는 기본적인 공정을 소개하고, 좀 더 진보된 공정과 디자인 방향을 이해할 수 있는 기 본지식을 제공한다. 그리고 물질의 범위를 제한 하기 위해서 이 강좌에서는 실리콘 프로세싱과 패키징에 관련된 물질만을 다루기로 한다.	The spectacular advances in the development and application of integrated circuit (IC) technology have led to the emergence of microelectronics process engineering as an independent discipline. Additionally, the pervasive use of integrated circuits requires a broad range of engineers in the electronics and allied industries to have a basic understanding of the behavior and limitations of ICs. This course presents an introduction to the basic processes common to most IC technologies and provides a base for understanding more advanced processing and design courses. In order to contain the scope of the material, we deal only with material related to silicon processing and packaging.	
학부 2005 - 2008 교육과 정	서울 공과대학 신소재공학부	IC 공학의 적용과 발전에 있어서 놀라운 발전이 독립적인 분야로서의 전자공학을 등장시켰다. 또한 IC의 광범위한 사용은 전자공학과 이와 관 련된 산업이 IC의 동작과 한계의 기본적인 이해 를 할 수 있는 다양한 영역의 공학도를 필요로 한다. 이 강좌는 대부분의 IC 테크놀로지에 공통적으 로 사용되는 기본적인 공정을 소개하고, 좀 더 진보된 공정과 디자인 방향을 이해할 수 있는 기 본지식을 제공한다. 그리고 물질의 범위를 제한 하기 위해서 이 강좌에서는 실리콘 프로세싱과 패키징에 관련된 물질만을 다루기로 한다.	The spectacular advances in the development and application of integrated circuit (IC) technology have led to the emergence of microelectronics process engineering as an independent discipline. Additionally, the pervasive use of integrated circuits requires a broad range of engineers in the electronics and allied industries to have a basic understanding of the behavior and limitations of ICs. This course presents an introduction to the basic processes common to most IC technologies and provides a base for understanding more advanced processing and design courses. In order to contain the scope of the material, we deal only with material related to silicon processing and packaging.	
학부 2001 - 2004 교육과 정	서울 공과대학 신소재공학부	ENE471 반도체공정 반도체 소자의 구조와 기본 특성을 살펴보고 소 자의 제조방법을 종합적으로 검토한다. 산화, 확 산, 이온주입, 식각기술, 박막제조, 패키징 등의 각 단위공정을 재료공학적 측면에서 자세히 다 루어 반도체 소자의 제조공정을 이해시키는 과 목이다.	ENE471 Semiconductor Processing This course introduces the structure of semiconductor devices, basic characteristics, and the fabrication processes. It offers oxidation, diffusion iron implantation, etching; thin film process, and packaging. It also introduces the fabrication processes of semiconductors from the materials science standpoint.	
	서울 공과대학 재료금속공학 부	반도체 소자의 구조와 기본특성을 살펴보고 소자의 제조방법을 종합적으로 검토한다. 산화, 확산, 이온주입, 식각기술 박막제조, 패키징 등의 각 단위공정을 재료공학적 측면에서 자세히 다루어 반도체 소자 제조공 정을 이해한다	This course introduces the structure of semiconductor devices, basic characteristics, and the fabrication processes. It offers oxidation, diffusion iron implantation, etching; thin film process, and packaging. It also introduces	

교육과정	관장학과	국문개요	영문개요	수업목표
			the fabrication processes of semiconductors from the materials science standpoint.	
학부 1997 - 2000 교육과 정	서울 공과대학 재료공학부	반도체 소자의 구조와 기본특성을 살펴보고 소자의 제조방법을 종합적으로 검토한다. 산화, 확산, 이온주입, 식각기술 박막제조, 패 키징 등의 각 단위공정을 재료공학적 측면에서 자세히 다루어 반도체 소자 제조공 정을 이해한다	This course introduces the structure of semiconductor devices, basic characteristics, and the fabrication processes. It offers oxidation, diffusion iron implantation, etching; thin film process, and packaging. It also introduces the fabrication processes of semiconductors from the materials science standpoint.	
학부 1993 - 1996 교육과 정	서울 공과대학 재료공학	AG U		

10. CQI 등목내역	
	No data have been found
	No data have been found.